

**EV Group develops heterogeneous integration process 'Expand cooperation with ITRI' – August 31, 2022**

MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 기업인 EV Group(EVG)은 대만 응용 기술 연구소 중 하나인 ITRI(Industrial Technology Research Institute)와 첨단 이종 집적 기술 개발을 위한 협력을 확대한다고 1일 밝혔다.

대만 경제부(MOEA) 산업 기술처(DoIT)의 지원을 통해, ITRI는 패키지 설계, 테스트 및 검증, 그리고 파일럿 생산을 아우르는 생태계를 형성함으로써 공급망 현지화 달성 및 사업 기회 확대에 기여하기 위한 목적으로 Hi-CHIP(Heterogenous Integration Chip-let System Package) 협력체를 구성했다.

EVG는 Hi-CHIP 협력체의 회원사로서 LITHOSCALE® 마스크리스 노광 리소그래피 설비, EVG@850 DB 자동 디본딩 설비, GEMINI@FB 하이브리드 본딩 설비 같은 첨단 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 설비를 제공한다.

ITRI의 최신 연구 시설에 이 같은 대량 생산 설비들이 설치됨에 따라 앞으로 EVG와 ITRI의 공통 고객들은 새로운 이종 집적 프로세스를 빠르게 개발하고 R&D에서 고객의 팹으로 신속히 이전할 수 있게 되었다.

3D 수직 적층 및 이종 집적이란 다수의 서로 다른 Components들과 Dies를 단일 디바이스나 패키지로 제조, 조립 및 패키징 하는 것을 뜻한다. 3D 및 이종 집적은 첨단 패키징에서 고대역폭 Interconnects를 가능하게 하므로 전반적인 시스템 성능을 향상시킬 수 있어 인공 지능(AI), 자율 주행, 기타 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위해서 중요한 역할을 한다.

MOEA는 'AI 칩 이종 집적 모듈 첨단 제조 플랫폼'이나 '프로그래머블 이종 3D 집적' 같은 국가적 차원의 R&D 프로젝트를 통해서 필요한 자원들을 적극적으로 지원 및 연결하고 있다.

ITRI의 전자 및 광전자 시스템 연구소 부소장인 로버트 로(Robert (Wei-Chung) Lo) 박사는 “우리 연구소에 EVG의 최신 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 솔루션을 포함한 완전 자동화 대량 생산 시스템을 설치함으로써, ITRI에서 개발된 프로세스를 곧바로 고객 팹으로 이전할 수 있게 되어 양산화 시점을 상당 기간 단축할 수 있게 되었다”고 말했다.

EV Group(EVG)의 영업 및 고객 지원 책임자이자 경영 이사회 이사인 허만 발틀(Hermann Waltl)은 “EVG는 Triple i(invent-innovate-implement) 원칙을 기반으로 ITRI 같은 세계적 연구소와 협력 관계를 맺고 반도체 산업의 혁신을 가속화하는 첨단 기술 개발과 상용화에 참여하고 있다”고 말했다.

[haezung2212@news1.kr](mailto:haezung2212@news1.kr)

<https://www.news1.kr/articles/?4790434>